

行业及产业

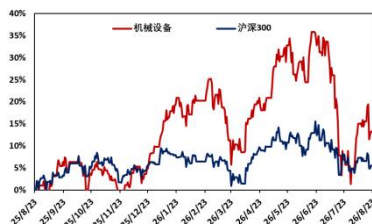
机械设备

东山精密追加光电投资，看好光设备景气上行

——光通信设备行业点评

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

相关研究

《天准科技(688003.SH)2026 半年报点评：AI 链精密装备整装待发，具身智能共驱成长》
2026-08-21

《光通信设备行业点评：英伟达 CPO 全面量产，测试设备需求加速释放》2026-08-17

《PCB 设备行业点评：mSAP 扩产元年，看好曝光、电镀环节设备增量机会》2026-08-10

《半导体设备行业点评：泛林半导体业绩超预期，看好存储及先进封装设备景气》2026-08-03

《半导体设备行业点评：先进制程设备交期延长，设备零部件景气延续》2026-07-27

证券分析师

王凯
S0820524120002
021-32229888-25522
wangkai526@ajzq.com

投资要点：

- **事件：东山精密上调光芯片及光模块投资额。**2026 年 8 月 21 日东山精密公告，拟对子公司索尔思光电、盐城东山等主体的光芯片及光模块扩建项目，新增投资额 5 亿美元，项目总投资额由 12 亿美元调增至 17 亿美元，扩产布局覆盖常州、泰国、盐城三地，核心投向 200G EML、CW 激光器等高速 InP 光芯片前道产线，以及配套光模块封装产能。我们认为，本次投资上调再次验证行业层面的加速趋势：AI 算力集群建设持续超预期，驱动光模块速率快速迭代，高速光芯片需求同步上修。头部厂商纷纷加码高速光芯片产能，验证当前高速光芯片供给偏紧、下游需求旺盛的产业现状，上游设备端将持续受益于本轮光通信资本开支上行周期。
- **AI 驱动光互连需求持续上修，高速光芯片结构性紧缺或延续至 2027 年中。**1) **800G 光模块维持高景气，1.6T 光模块加速放量，拉动高速光芯片需求持续扩容。**据 LightCounting 2026 年 7 月预测，2026 年全球以太网光模块销售额预计同比增长 73%(较 4 月 65%的预测进一步上调)。产品端，800G 光模块需求延续高景气，1.6T 光模块加速放量，单通道速率升级至 200G/lane，带动 200G EML 及高功率 CW 激光器需求增长。Lumentum 26Q4 业绩会披露，200G EML 收入占 EML 业务比重已超 25%，反映高速光芯片正加速放量。2) **供给端进入集中扩产周期，但有效产能释放仍滞后于需求。**TrendForce 预计，2026 年全球 EML 及 CW-DFB 合计月产能将大幅提升至 5,070 万颗，头部厂商均在加快 InP 光芯片扩产，其中 Lumentum 计划于 2026 年底将 EML 产能较 2025 年底提升 50%以上。尽管行业产能快速扩张，但新增产能仍需经历设备导入、工艺验证及良率爬坡，而下游 800G/1.6T 需求持续上修，供给释放速度仍难匹配需求增长，LightCounting 预计 InP 激光器短缺可能延续至 2027 年中，高速光芯片供给仍是制约 AI 光模块产能释放的重要环节。
- **InP 光芯片扩产兼具产能扩张与工艺升级属性，我们判断：本轮 InP 高速光芯片设备资本开支的核心增量，一方面来自前道晶圆产线扩产与 4 英寸向 6 英寸平台升级，另一方面来自芯片级 KGD 前置测试能力建设。**前道扩产决定“能产多少”，测试筛选决定“能用多少”，对应设备配置需求有望持续提升。1) **前道直接决定产能与器件性能**，EML/CW 扩产将拉动 MOCVD、光刻、刻蚀、薄膜沉积及金属化等晶圆制造设备需求；部分头部厂商同步推进 6 英寸 InP 平台，有望进一步提升大尺寸兼容及自动化设备需求。2) **测试端**，随着 200G EML 等高速芯片价值量提升，失效芯片进入 CoC 及模块封装后的成本损失放大，EML 测试因此更多前移至 Bar/Die/CoC 等封装前环节，提升 KGD 筛选、老化及自动分选需求；硅光路线则同步拉动晶圆级光电测试及耦合设备需求。
- **投资建议：**我们认为，本轮光芯片扩产的设备增量有望优先落在 InP 前道制造与芯片级测试，并向高精度封装、耦合及自动化环节延伸，建议关注：1) **【真空镀膜设备】**汇成真空 (301392)；2) **【光测试】**联讯仪器 (688808)、华兴源创 (688001)；3) **【后道及自动化】**智立方 (301312)；4) **【耦合及封装】**罗博特科 (300757)；5) **【硅光晶圆级测试】**燕麦科技 (688312)；6) **【精密检测】**天准科技 (688003)、科瑞技术 (002957)。
- **风险提示：**1) AI 光互连需求不及预期；2) InP 光芯片扩产及良率爬坡不及预期；3) 硅光/CPO 等技术路线变化；4) 设备客户导入及订单兑现不及预期。

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15%之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5%之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。